

PCB 焊接工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	ARES8050_MID_V1.1	焊接	QM03321101902	V1.1	1/3	20211019

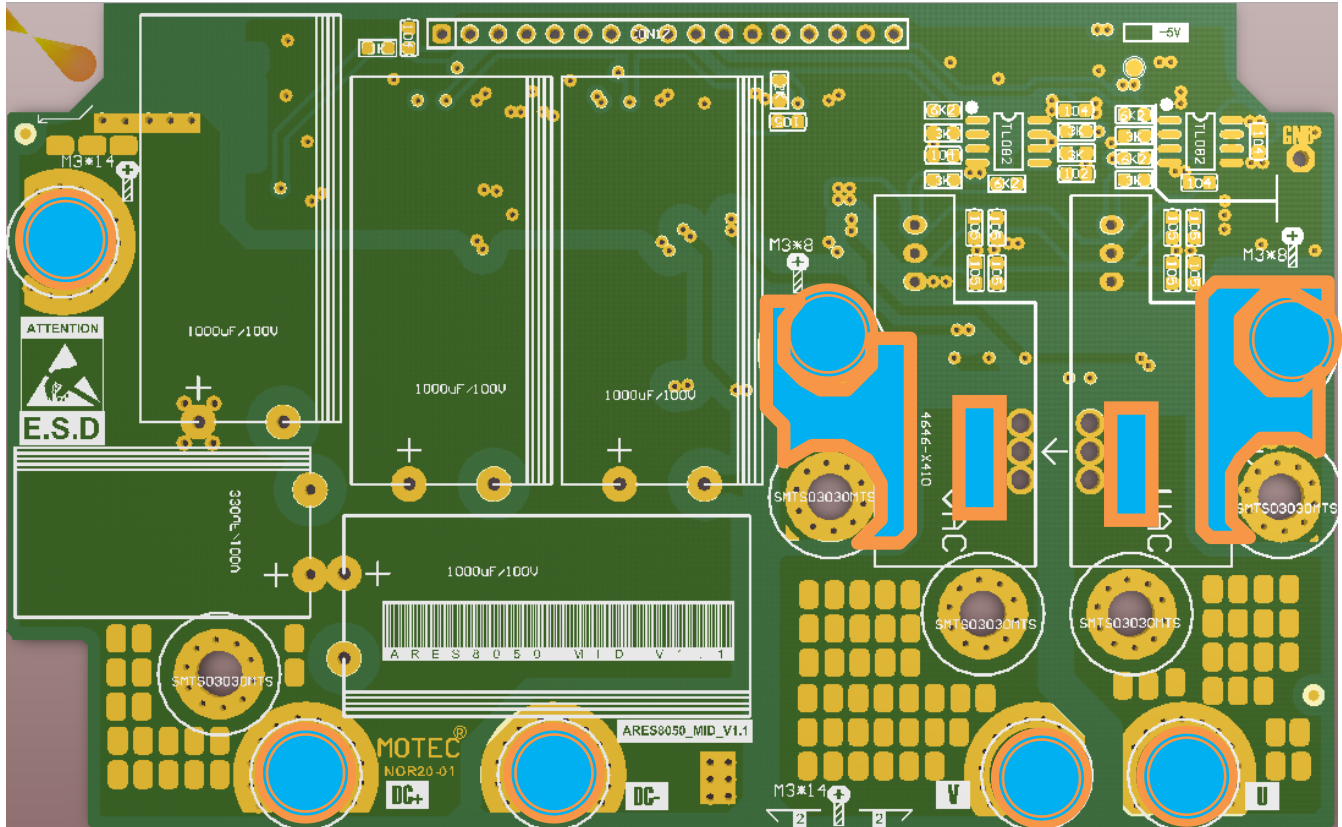
1 ARES8050_MID_V1.1 金 PAD 禁止沾锡位置及高温胶带覆盖区



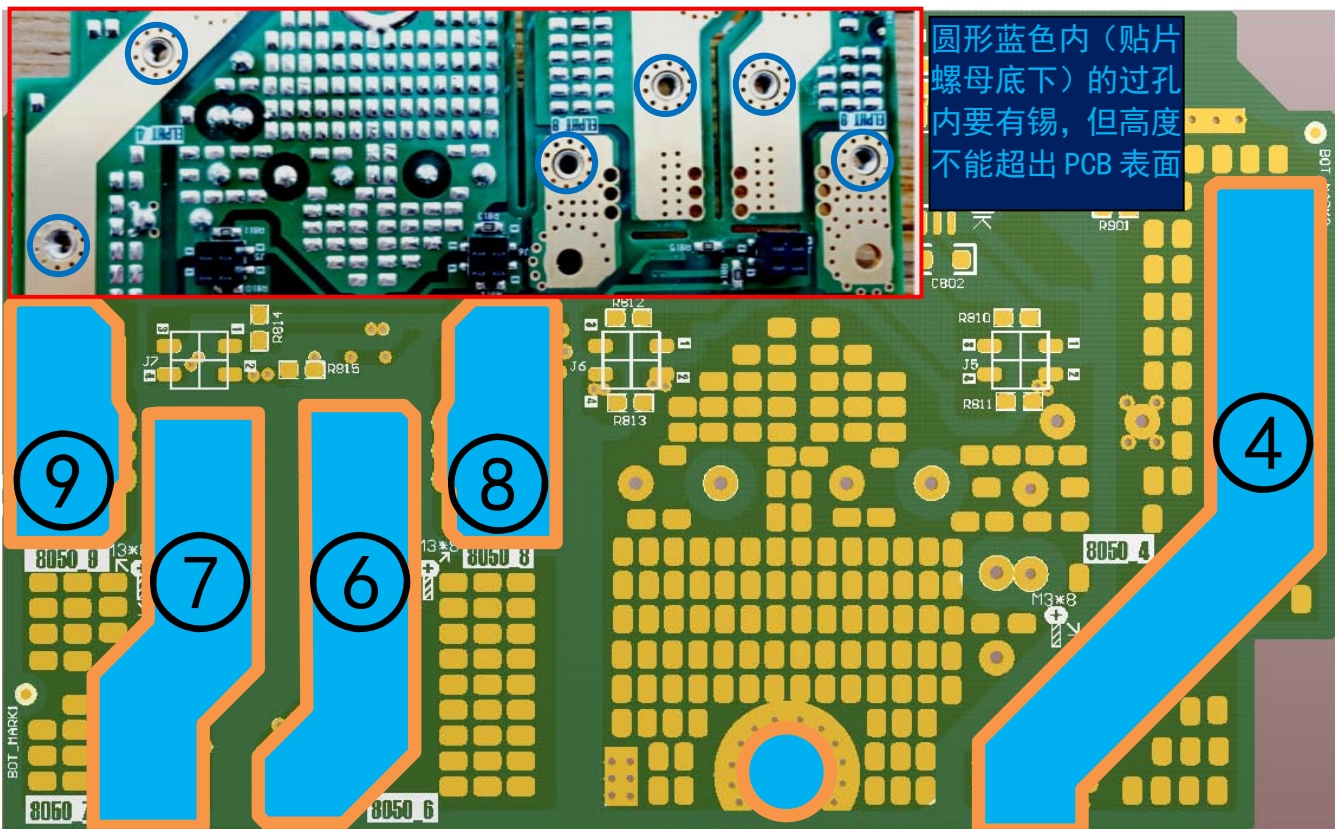
禁止沾锡位置图,具体为橙色框蓝底标注区域

④-→⑨5 处标识区域为铜排放置区,禁止被污染和氧化,打开 PCB 第一时间使用高温胶带覆盖

2) 顶层



2) 底层

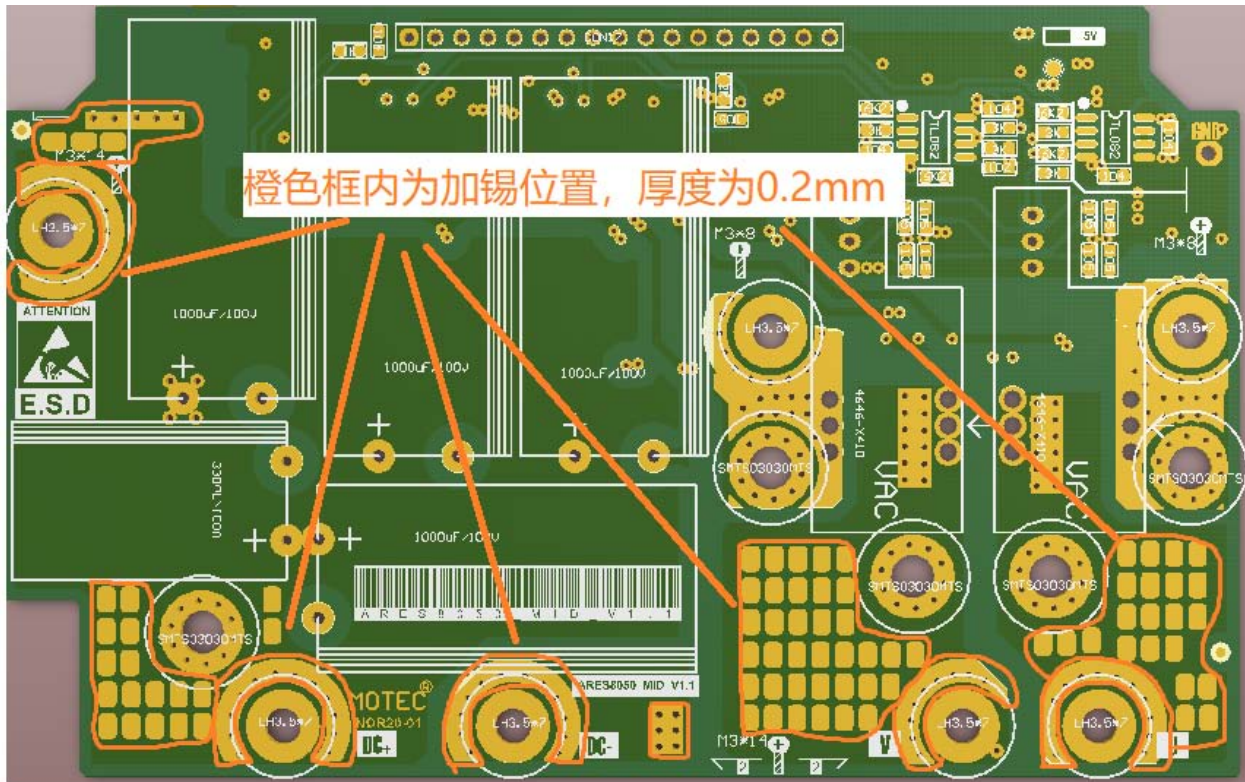


PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	ARES8050_MID_V1.1	焊接	QM03321101902	V1.1	2/3	20211019

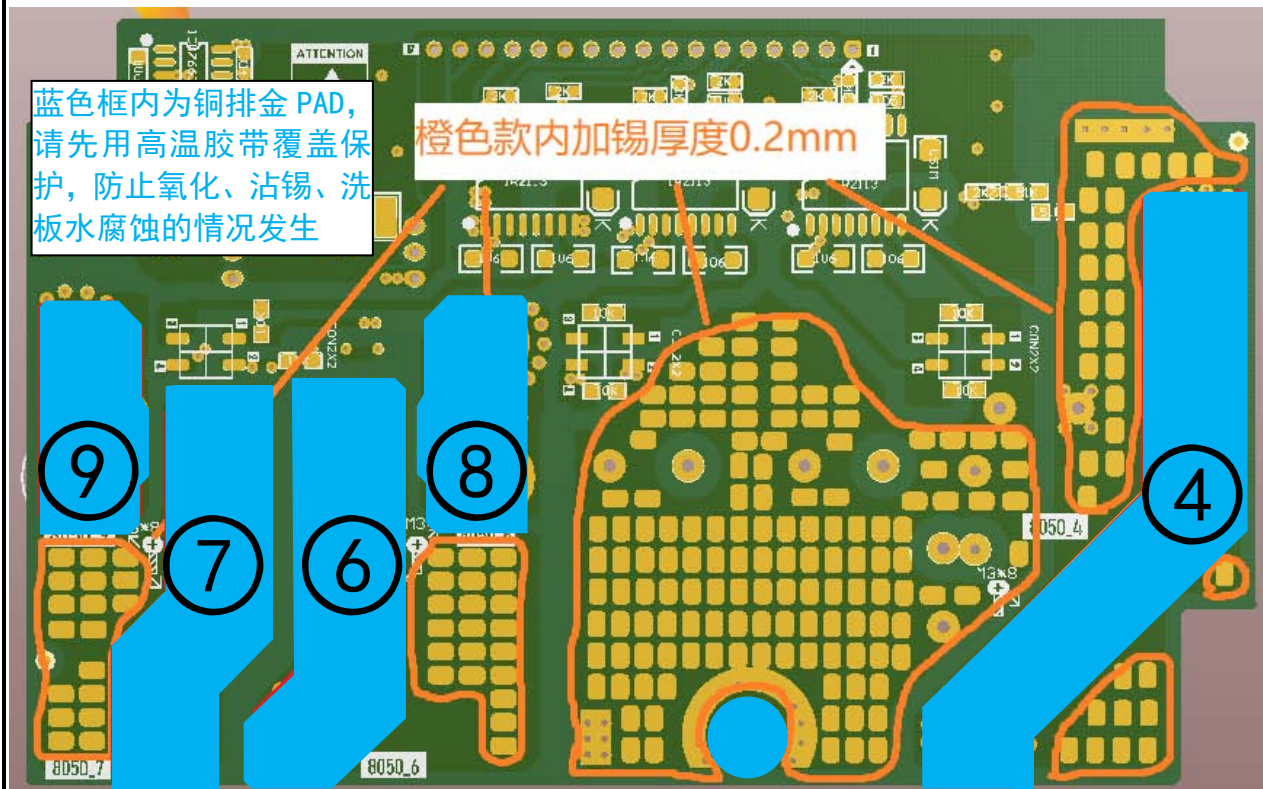
2 ARES8050_MID_V1.1 加锡位置图

具体为**橙色框**标注区域

1)顶层



2)底层



PCB 焊接 工艺要求	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
	直流伺服	ARES8050_MID_V1.1	焊接	QM03321101902	V1.1	3/3	20211019

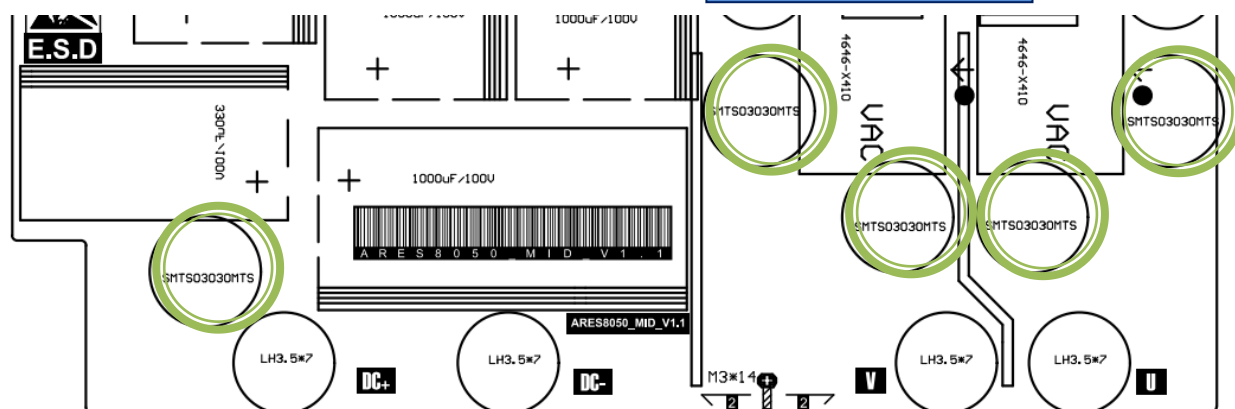
3. 焊接基本要求

贴片螺母规格区分

SMTS03030MTS (绿字符为高度: 030 为 3mm 高)



ARES8050_MID_V1.1 及
贴片螺母均贴装在顶层



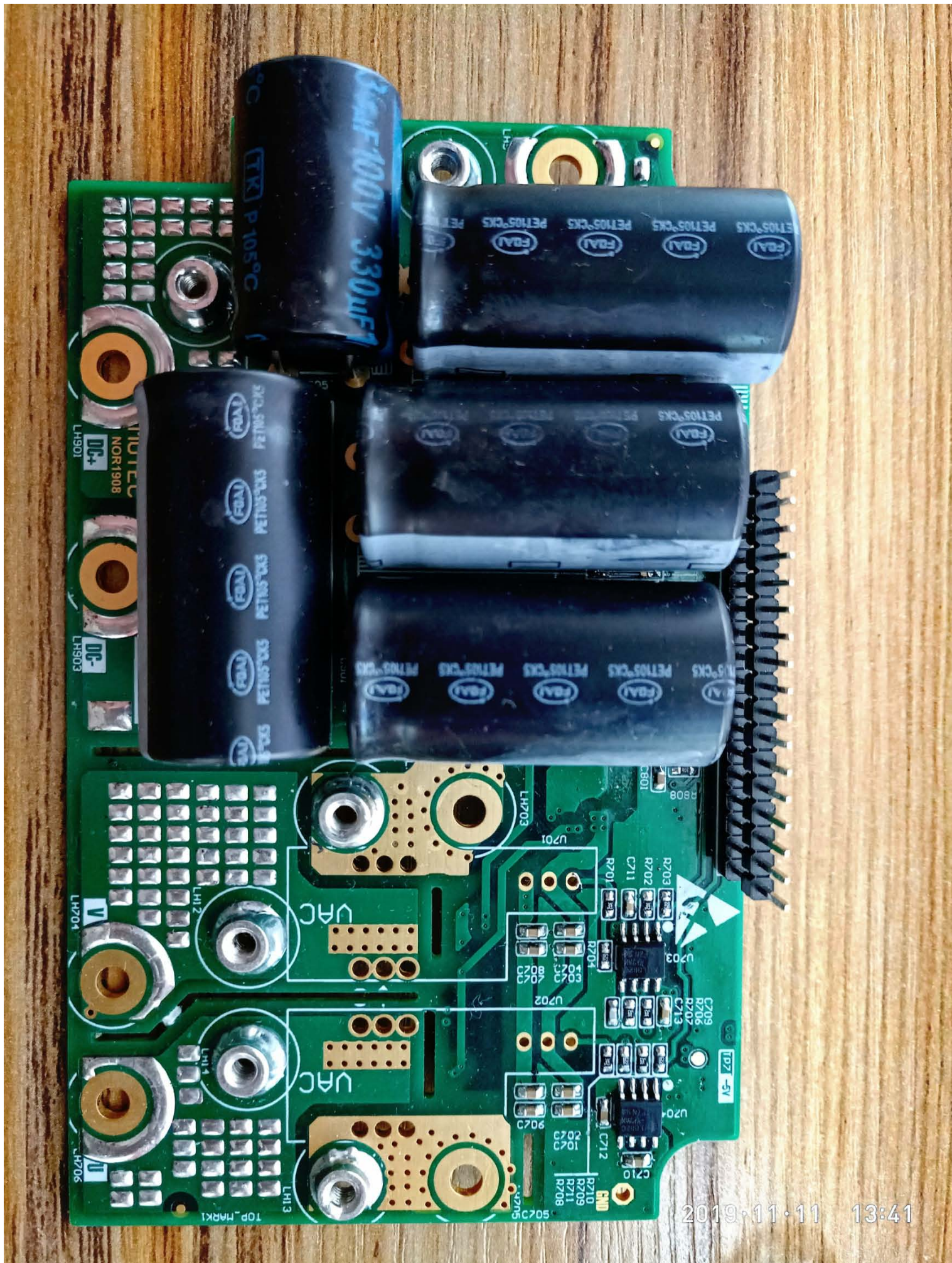
注意事项:

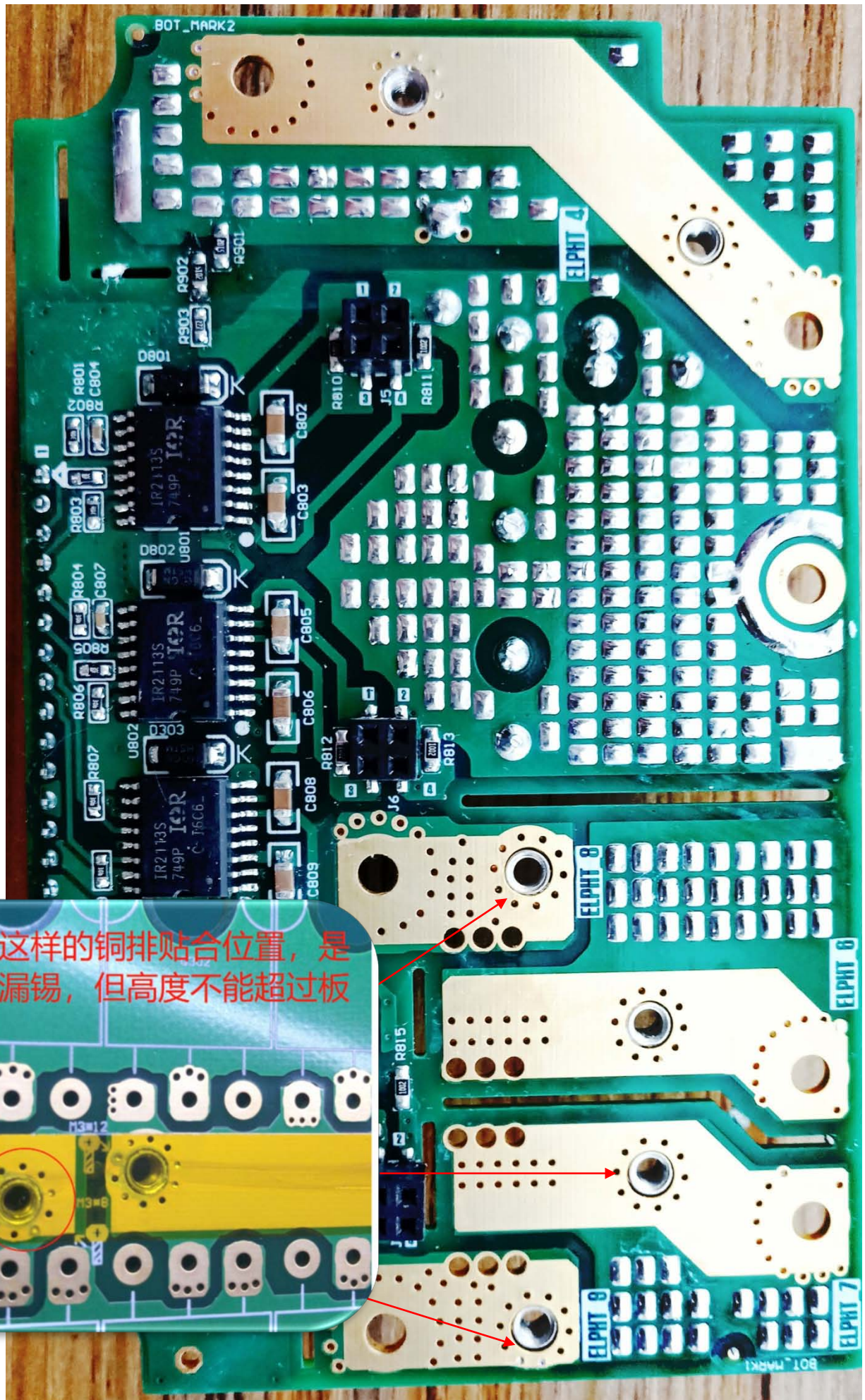
1. 贴片螺母焊接要求不能歪斜, 必须垂直于 PCB 落到底部焊接;
2. 贴片螺母保证完全与 PCB 接触焊接 (禁止浮高);
3. 贴片螺母顶部不能沾锡;
4. 洗板水不能污染金 PAD;
5. 排针排母居中, 对齐中心位置焊接, XY 方向偏差小于 0.3mm, 严禁浮高现象, J1 插针不允许弯曲变形;
6. C901~C905 计 5 个电解电容引线管脚直角折弯, 卧位对应丝印极性焊接, 在电容与线路板接触的区域, 长宽为: 电容等长*5mm 内涂覆黑色 704 胶 (过程: 点胶在电容上、电容固定在板子上、焊接);
7. U701, U702 (暗红色) 模块与铜排焊接要求:
 - 1) 先把 U701, U702 模块预焊接, 细管脚可以完全焊接, 期间一定保证这两个模块本体垂直于 PCB, 不能歪斜; 如果焊接歪斜, 该板将无法与上板组装, 而且修正很困难, 因为该模块与铜排焊接在一起;
 - 2) 在底层使用 M3*8 的不锈钢组合螺钉, 依次把 8050-6, 7, 8, 9 号铜排, 字符朝上固定到相应的标号位置上, 固定时保证铜排孔位与 PCB 相应孔位对正;
 - 3) 焊连铜排与模块的粗管脚, 焊接要求:
 - A) 不能虚焊, 铜排与管脚完全焊连, 焊接完后锡面高度不超过 0.2mm, 且管脚与 PCB 焊接良好;
 - B) 焊接时先使用烙铁头加热铜排, 待温度达到可焊温度后, 在铜排与管脚间加锡焊, 管脚加热时长不能超过 8 秒 (铜排可加热时间 15 秒), 若焊接时间过长, 会导致模块管脚处塑料外壳融化变形;



编制	安长江	审核		批准	
日期	2020-04-17	日期		日期	

以下为未焊接 U701, U702 的图片（焊接的请看上页）





类似这样的铜排贴合位置，是可以漏锡，但高度不能超过板面